



**0.75mm (.030") Pitch  
AMC.0 B+  
170-Circuit Connectors**

- 75800 Standard**
- 75908 Pegless**
- 75791 Extended Height**



Series 75800 Standard AMC.0 B+ Connector

**AMC.0 B+ connectors from Molex support the next generation of mezzanine card standards and 12.5 Gbps speeds**

The 170-circuit AMC.0 B+, or AdvancedMC™ connectors from Molex support the next generation of mezzanine card standards that allow for hot-plugging of high-speed serial interconnects. These connectors support AdvancedTCA (Advanced Telecommunications Computing Architecture), a standard developed by PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group).

Molex AMC.0 B+ connectors feature controlled impedance and reduced crosstalk, plus a footprint launch optimized for high-speed data rates. This design enables the connector to achieve 12.5 Gbps NRZ (Non Return to Zero) signal transmission. This enhanced

footprint further reduces crosstalk by managing inter-pair affinity and incorporating additional ground vias for isolation. As a result, the AMC.0 B+ connectors achieve crosstalk of less than 3 percent at 12.5 Gbps.

Three versions of the Molex AMC.0 B+ connector exist: the standard connector with locating pegs (series 75800), connector without pegs (series 75908) and the 1.15mm (.045") extended-height connector (series 75791). This taller height is optimized for blade-server applications where cooling is critical.

**Features and Benefits**

- Insert-molded wafer design provides excellent electrical performance
- Press-fit contacts and high-speed footprint for simpler application to PCB and superior signal integrity than competition
- Tin or Tin-Lead tail plating supports RoHS requirements and customer preferences for press-fit
- Meets PICMG Advanced MC™ specification and industry standard requirements

SPECIFICATIONS

**Reference Information**

Packaging: Tray  
 UL File No.: E29179  
 CSA File No.: LR19980  
 Mates With: AMC module  
 Designed In: Millimeters

**Electrical**

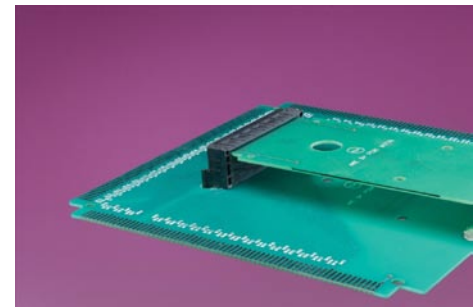
Voltage: 250V AC  
 Current: 1.5A Power Terminal  
           1.0A Other Terminals  
 Contact Resistance: 60 milliohms max.  
 Dielectric Withstanding Voltage: 80V RMS  
 Insulation Resistance: 500V DC

**Mechanical**

Insertion Force to PCB: 6050N (1360 lbf) max.  
 Mating Force: 100N (22 lbf) max.  
 Unmating Force: 65N (14 lbf) max.  
 Durability: 200 cycles

**Physical**

Housing: Black Thermoplastic  
 Contact: Copper (Cu) Alloy  
 Plating:  
     Contact Area — 0.76µm Gold (Au)  
     Solder Tail Area — Tin or Tin-Lead (Sn or Sn/Pb)  
     Underplating — Nickel (Ni)  
 PCB Thickness: 2.36mm (.092")  
 Operating Temperature: -40 to +105°C



## APPLICATIONS



# 0.75mm (.030") Pitch AMC.0 B+ 170-Circuit Connectors

- Telecommunications equipment
- For use in the IEEE 1386 market as it transitions to serial buses
- General "blade" computing applications
- Extended-height version used in non-ATCA applications
- Any hot-pluggable high-speed serial bus application

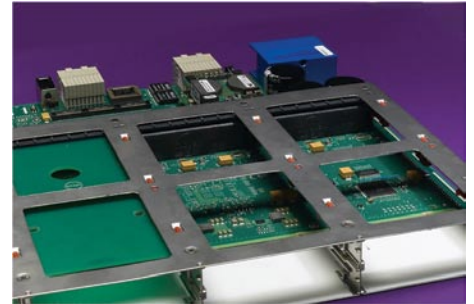
**75800** Standard  
**75908** Pegless  
**75791** Extended Height



ATCA Rack



ATCA Carrier



## ORDERING INFORMATION

Order No.	Comment	Tail Plating	Height	PCB Peg
75800-0001	With alignment pegs	Tin plated	21.85mm (.860")	Yes
75800-0002	With alignment pegs	Tin/Lead plated	21.85mm (.860")	Yes
75908-0001	Without alignment pegs	Tin plated	21.85mm (.860")	No
75908-0002	Without alignment pegs	Tin/Lead plated	21.85mm (.860")	No
75791-0001	Extended height	Tin plated	23.0mm (.905")	Yes
75791-0002	Extended height	Tin/Lead plated	23.0mm (.905")	Yes

**Americas Headquarters**  
Lisle, Illinois 60532 U.S.A.  
1-800-78MOLEX  
amerinfo@molex.com

**Asia Pacific North Headquarters**  
Yamato, Kanagawa, Japan  
81-462-65-2324  
feninfo@molex.com

**Asia Pacific South Headquarters**  
Jurong, Singapore  
65-6268-6868  
fesinfo@molex.com  
Visit our website at [www.molex.com](http://www.molex.com)

**European Headquarters**  
Munich, Germany  
49-89-413092-0  
eurinfo@molex.com

**Corporate Headquarters**  
2222 Wellington Ct.  
Lisle, IL 60532 U.S.A.  
630-969-4550  
Fax: 630-969-1352



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.